

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-017

## 鸿合科技股份有限公司

### 关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、拟申请的综合授信额度情况

为满足公司及子公司2024年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟在2024年度向银行申请总额不超过人民币或等值外币21亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。

上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授信额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在授信额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。

#### 二、对公司的影响

截至目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次公司及子公司向银行申请授信额度是依据公司日常生产经营活动的实际需要，有利于补充公司的流动资金及促进公司的业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生负面影响。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第三届董事会战略委员会第三次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024年4月26日